

スマートフォン/タブレット

セットトレンド

- CPU/GPU高性能化
- フルHD解像度
- 薄型/軽量化
- 高精度LCDパネル
- 高音質 (Hi-Fi)

電源回路の動向

- 負荷電流の増加
- MLCCの音鳴き対策

- ① パワーアンプ回路
- ② CPU/GPUコア
- ③ 音質改善

キャパシタ 要求仕様

大容量

低背

小形化

推奨商品特長

POSCAP

- 小形化(3528)
- 低背(1.1mm~)



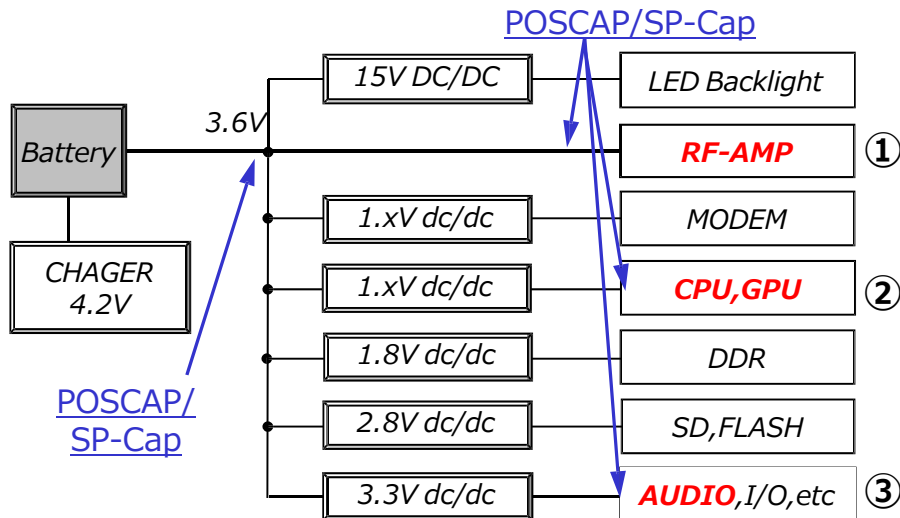
SP-Cap

- 大容量
- 低背(1.0mm~)



推奨回路

- ① Power Ampバックアップ
- ② CPU/GPU
- ③ 音質改善



音鳴き対策

